



PROGRAMA

XXII Congreso Internacional *Adhesión y Adhesivos*

2023
16-17 nov.

WORKSHOP

15 nov.
MÁLAGA

www.congreso adhesivos.com

COLABORADORES



uc3m

Universidad Carlos III de Madrid



PATROCINADOR



ORGANIZADORES



Miércoles 15 noviembre 2023

9:00	<i>Apertura</i> Workshop "Los adhesivos como elementos clave en el desarrollo del packaging sostenible"
9:10	Packaging adhesives: confronting challenges and embracing opportunities Carlos Ruzafa Silvestre (ASEFCA)
9:45	El caucho como oportunidad para un packaging más sostenible: desarrollos estireno-butadieno para adhesivos hot-melt libres de aceite Alicia de San Luis González (Grupo Dynasol)
10:20	Obligaciones y Oportunidades para los envasadores del sector adhesivos según el nuevo RD 1055_2022. Presentación SCRAP de IMPLICA Laura Sanz de Siria (CONFECOI)
10:55-11:30	COFFE BREAK
11:30	Estudios de migración de adhesivos biodegradables para contacto alimentario Paula Vera Estacho (Universidad de Zaragoza)
12:05	Ecodiseño de envases. Influencia de los adhesivos en el diseño de packaging Rosa Ocaña López (Universidad Politécnica de Madrid)
12:40	Evaluar el impacto ambiental de los adhesivos en el packaging: una prioridad sostenible Borja Mateu Romero (INESCOP)
13:15-14:50	LUNCH
14:50	Nuevos adhesivos para la fabricación de embalaje sostenible de papel y cartón Alicia Gordon Vergara (QUILOSA-Selena Iberia)
15:25	Los adhesivos como elemento clave en el desarrollo de envases multicapa sostenibles Teresa Calvo (ITENE)
16:00	Ayudas Públicas para apoyar las actividades de I+D+I en adhesivos para packaging sostenible María José Tomás (CDTI)
16:35	Mesa redonda: Retos y oportunidades de los adhesivos en el sector de los envases
17:00	<i>Clausura</i> Workshop

Jueves 16 noviembre 2023

9:30 *Apertura XXII Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos*

9:40* Reshaping the future of the adhesive industry through the sustainability
F. Arán Ais (GEAA, España)

Sesión 1: Síntesis y formulación de adhesivos

Moderador:

10:20 Síntesis y caracterización de adhesivos de poliuretano reversible mediante funcionalización Diels-Alder
A. Moyano, M.P. Carbonell-Blasco, F. Arán-Ais, E. Orgilés-Calpena (INESCOP, España)

10:40 Estrategias de mejora de las propiedades de adhesión en termoestables tiol-acrilato-epoxi mediante procesado de curado dual secuencial
S- De la Flor, C.Russo, X. Fernández-Francos, D. Santiago (Universitat Rovira i Virgili, España)

11:00 Nuevas formulaciones de poliuretano biobasadas
O. Echeverría, I. Harismendy, B. Pérez, S. Flórez, A. Eceiza (Tecnalia, España)

11:00-11:40 **COFFEE BREAK**

11:40 PSAs base agua híbridos acrílico-poliuretano biobasados
N. Fernández, O. Echeverría, I. Calafel, R. Rodríguez (Tecnalia, España)

Sesión 2: Impacto ambiental de los adhesivos

Moderador:

12:00 Reducción del impacto ambiental en adhesivos de poliuretano
C. Hernández-Fernández, C. Ruzafa-Silvestre, A. Moyano, M.P. Carbonell-Blasco, F. Arán-Ais, E. Orgilés-Calpena (INESCOP, España)

12:20 Environmental assessment of commercial vs. Biobased adhesives: A technical comparative analysis
B. Mateu-Romero, C. Ruzafa-Silvestre, F. Arán-Ais, A.B. Muñoz-Milán, E. Orgilés-Calpena INESCOP, España)

12:40-14:00 **LUNCH**

14:00* **Pendiente a confirmar**

14:40 ¿Cómo afecta el nuevo reglamento REACH a los adhesivos, selladores y espumas de poliuretano?
G. Blanco, Y. Serrano (SIKA, España)

Sesión 3: Aplicaciones de adhesivos de interés industrial

Moderador:

15:00 Nuevos materiales compuestos de matriz termoplástica líquida reforzada con prepreg aeroespacial caducado reciclado por vía mecánica
J.A. Butenegro-García, M. Bahrami, M.A. Martínez-Casanova, J. Abenojar-Buendía (Universidad Carlos III de Madrid, España)

15:20 Estudios previos de adhesión y durabilidad de recubrimientos sobre caucho para neumáticos
M.A. Martínez-Casanova, J. Abenojar-Buendía, D. Garcia-Pozuelo Ramos, I. Requena, J.A. Butenegro-García (Universidad Carlos III de Madrid, España)

15:40-16:10 **COFFEE BREAK**

Autor subrayado-> ponente
*Ponencia plenaria

16:10	Aportación del metacrilato al curado de adhesivos de cianocrilato B. Pérez Allende, O. Echeverría Altuna, J. Abenojar Buendía, S. Flórez Fernández, M.A. Martínez Casanova (Universidad Carlos III de Madrid, España)
16:30	Enhancing Adhesive Bonding Personnel's Expertise: European Adhesive Bonder A.Q. Barbosa, E. Meiß, A. Almeida, T. Avelino, F. Mañas, M. Uran, M. Tonnhofer, E.A.S. Marques, R.J.C. Carbas, L.F.M. da Silva (Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), Portugal)
16:50	Migración de adhesivos utilizados en corchos para champagne P. Vera Estacho, E. Canellas Aguarrelles, C. Nerin de la Puerta (Universidad de Zaragoza, España)
17:10	Cierre
17:20	Asamblea General Grupo Español de Adhesión y Adhesivos (GEAA)(solo socios)
20:30	Cena de gala

Viernes 17 noviembre 2023

9:00* Claves de la actualidad normativa en materia de envases y residuos de envases: nuevas tendencias en torno a la circularidad
M.B. García (PACKNET, España)

Sesión 4: Ingeniería de la adhesión

Moderador:

9:40 Análisis del comportamiento mecánico de uniones adhesivas flexibles expuestas a altas temperaturas
F.J Simón-Portillo, O. Cuadrado-Sempere, L.F.M. da Silva, M. Sánchez-Lozano (Universidad Miguel Hernández de Elche, España)

10:00 Mecanismos de re-adhesión y reciclaje de adhesivos vitriméricos
D. Santiago, M. Surós, P. Verdugo, S- De la Flor (EURECAT, España)

10:20 Cinética de descomposición y estimación de tiempo de vida de materiales compuestos termoplásticos reforzados con rCFRP
J. Abenojar Buendía, G.M. Aparicio, J.A Butenegro García, M. Bahrami, M.A. Martínez Casanova (Universidad Carlos III de Madrid, España)

10:40-11:00 **COFFEE BREAK**

11:00* Validation of the use of average stress to express tensile bond strength from ISSF=const
N.A. Noda (Kyushu Institute of Technology, Japón)

Sesión 5: Técnicas de caracterización de adhesivos y superficies

Moderador:

11:40 Examination of adhesive strength of lap joints with different joint end shapes using the interface crack model
K. Oda, M. Takeo, H. Oda, K. Ide (Oita University, Japón)

12:00 ISSF analysis to express the adhesive strength of the stepped-lap joint
R. Takaki, N.A. Noda, B. Wang (Nippon Bunri University, Japón)

12:20 Aplicación de la inteligencia artificial en la identificación de defectos en uniones adhesivas empleando el método de resonancia sónica
C. Teis, J. Fontana, L. Molisani, R. O'Brien, Y. Ballesteros, J.C. del Real (Universidad Pontificia Comillas, España)

12:40 Presentación EURADH2025 y XXIII Congreso Internacional de Adhesión y Adhesivos

12:50 Premio a la Mejor Presentación 2023

12:40 **Clausura del congreso**

13:00 **LUNCH**